



検査&ものづくりイノベーション研究会

2025年度公開研究会

◆公開研究会のご案内 研究会テーマ

高密度実装時代の「検査ファースト」

～検査にAI技術を取り込む前に「いま」何をすべきか～

近年、チップレット実装や部品内蔵基板、3D実装などの技術革新により、実装基板の高密度化が急速に進んでいます。それに伴い、従来の検査方法では対応しきれない『見えない・観えない・診えない不良』の検出が大きな課題となっています。さらに、競争力のあるものづくりを実現するためには、省人化などの検査コスト最適化も求められています。

いま注目されているAI技術の導入で成果を上げるためには、検査員による認知判断プロセスの標準化や検査データの整備、更にテスト容易化設計（DFT）などの基礎的な取り組みが欠かせません。

そこで本公開研究会では、「AI技術を導入する前に『いま』なにをすべきか」という視点から、高密度実装における検査技術の活用方法、ハイブリッド検査の工夫と実践、さらに設計と検査の連携による品質向上、といったテーマについて実例を交えて多角的に議論します。また、会場限定で、講演者と参加者によるパネルディスカッションを行います。製造現場の課題を共有し、検査の底上げを目指し貴重な意見交換を行います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

開催日時： 2025年12月12日（金） 13:00～17:00

開催方式： ハイブリット（会場：先着30名）

開催場所： (株)デンソー 東京支社 [アクセスマップ](#)

東京都港区新橋4丁目3-1 新虎安田ビル10階

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

○13:00 開会の挨拶

*13:05 講演1 「検査技術委員会の歩みと検査ファーストとは」

委員長 内山 浩志（株式会社ニューリー・土山）

*13:50 講演2 「DFTによる電気検査の効率化とBGA基板の故障解析の事例」

～JTAGテストとインサーキットテストのハイブリッド検査～

アンドールシステムサポート株式会社 谷口 正純 氏

*** 14:30 講演3 「X線検査による高密度パッケージの解析事例と活用」**

～AI技術の活用とその可能性について～

テクノホライゾン株式会社 野口 健二 氏

*** 15:00 パネルディスカッション：「検査ファーストとは」※会場限定です**

委員長 内山浩志（株式会社ニューリー・土山）

○**16:00 閉会の挨拶**（終了後に懇親会を17:00まで予定）

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定 員 デンソー 東京支社：40名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
WEB：100名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参 加 費(消費税込み)

正会員：5,000円、学生会員：1,000円、シニア会員：2,000円、名誉会員：無料、MF：無料、
賛助会員の社員：5,000円、賛助会員(クーポン利用)：無料

非会員一般：10,000円、非会員学生：2,000円、協賛団体(JPCA会員)：5,000円

注意事項(参加方法)

①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。

②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。

(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)

③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。

④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。

⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

* キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。